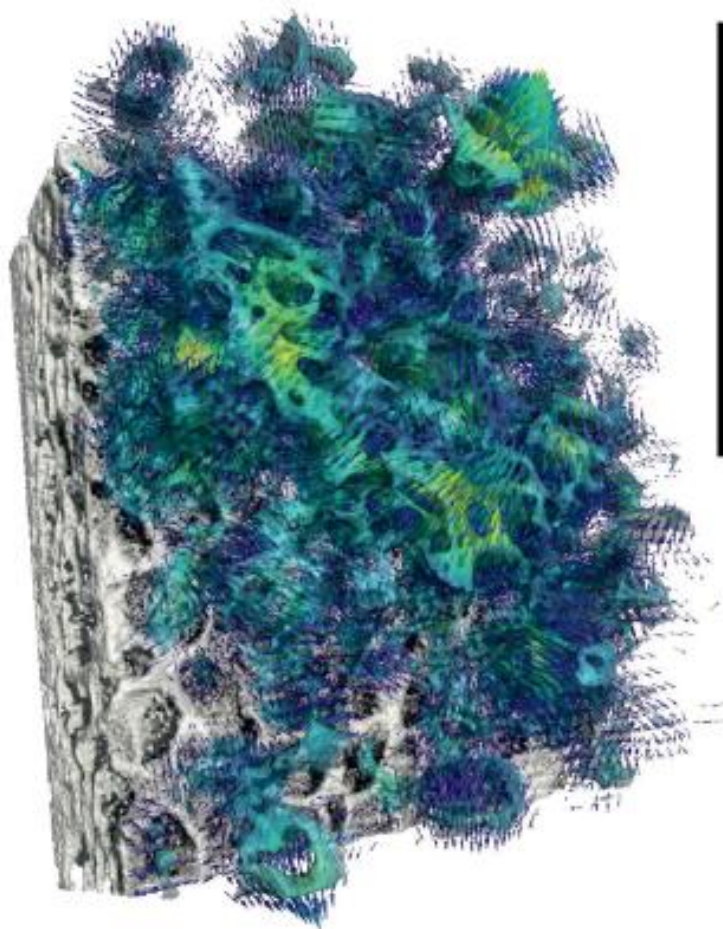


生物・材料研究のための高度3D画像処理ソフトウェア

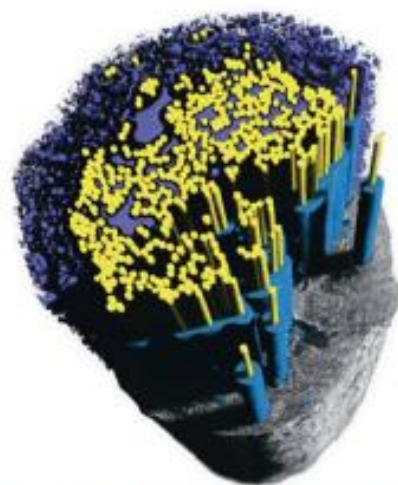
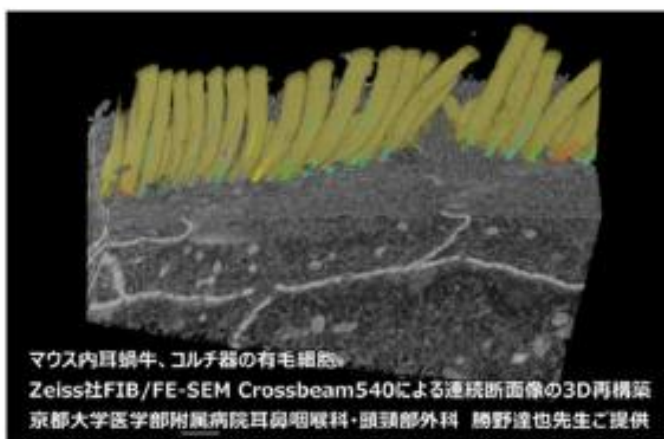
dragonfly

AIによる先進的セグメンテーション機能搭載
SEM/TEM, CT, MRI, 光学顕微鏡の3D画像解析に最適

- ✓ 洗練されたGUIでインパクトある可視化と高度な解析が実現可能
- ✓ 汎用の電子線, X線, 光学顕微鏡等、あらゆる連続画像データが処理可能
- ✓ 初心者にも扱いやすいウィザード形式による操作でAIセグメンテーションを実現
- ✓ 経験豊富なスタッフによる的確なテクニカルサポートの提供



Vector field mapping of a 4D deformation study looking at the interface between an AM spacer and a human vertebrae while undergoing continuous compression. CT data courtesy of TESCAN, sample courtesy of Rush University.



Ceramic composite image segmentation
ALS synchrotron microCT 0.65um pixel size, 20,000 reconstructed slices (Aly Badaran, University of Colorado)

Dragonfly機能概要

画像処理

Bilateral, Gauss, Mean, Mean Shift, Median, Canny, Dif, Laplacian, Prewitt, Scharr, Sobel, CLAHE, Local Histogram Equalization, Texture analysis, Morphological filters, Otsu, other thresholding, Arithmetic operation, Batch processing, 縞状アーティファクト、リングアーチファクト除去、Membrane Projections, Anisotropic Diffusion, Adaptive Gaussian, 断面の自動位置合わせ

セグメンテーション

機械学習セグメンテーション, Active Contour, 2/3D Tools(Brush, Point-and-Click, Grow), 閾値処理, セグメンテーションされた領域のDilate, Erode, Open, Close, ブーリアン演算、Watershed分割

可視化機能

MPR+3D/4D viewing(連動), Clipping, 高性能ボリュームレンダリング, 豊富なカラーマップ, 高性能サーフェスレンダリング, Fusion/Registration(Manual, Auto)

計測項目

長さ, 角度, 表面積, 体積, 粒子の方位, 3D形状の再構成, 形状の厚み, 他組織との境界面積, 屈曲度, 最短経路, 三相界面の抽出

プレゼンテーション

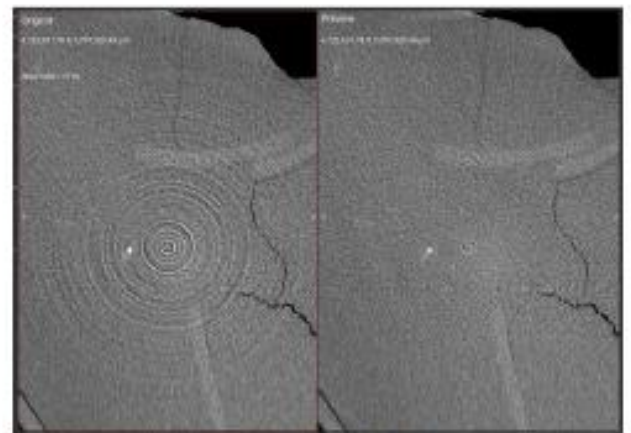
アノテーション, 高解像度のスナップショット出力, アニメーション動画出力, 操作動画のキャプチャ

自動化と機能拡張

Pythonスクリプトによる機能拡張, マクロの記録と再生, Infinite Toolboxによる拡張機能の共有

データ入力

Image stacks (Tiff, JPEG, PNG, BMP), MRC, REK, Analyze7.5, DICOM3.0, RAW data

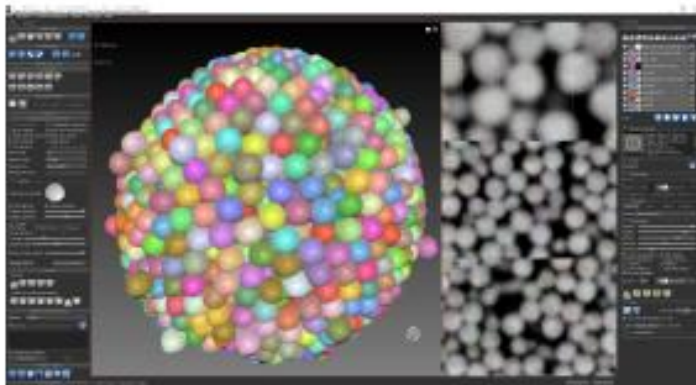


CT像のリングアーチファクト低減
データ提供: JASRI / SPring-8上杉健太郎 先生

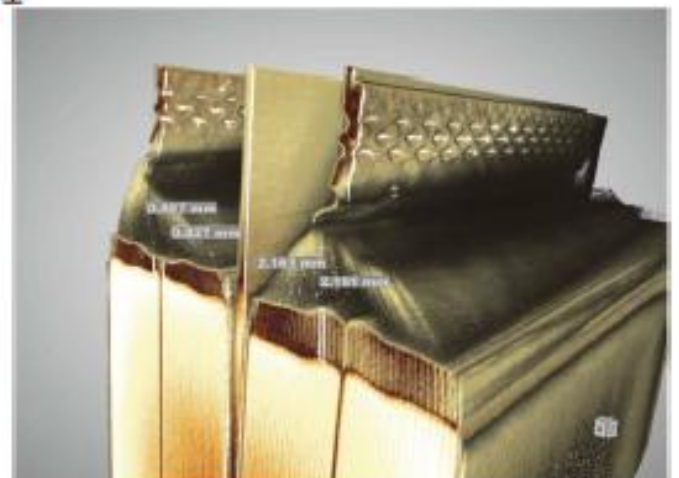
オプション製品

深層学習拡張機能 Deep Learning

- 学習済みモデルによるセグメンテーション、ノイズ低減処理
- GUIによるモデル生成、設定、学習



3D-UNetによるシリカボールのセグメンテーション



Battery Inspection for Overhang Distances

CERVO Grasta

「Dragonfly」動作推奨モデル

動作推奨ワークステーション協業リリース

INTEL XEON、Core Ultra、AMD Threadripper 搭載可能



3年間
保証

 **nVIDIA. RTX PRO6000搭載**

- OS: Windows11 Pro 64bit
- 光学ドライブ: 非搭載
- チップセット AMD TRX50 チップセット DDR5 4DIMM
- 電源1,200W/100V | 1,500W/200V
(80 Plus Platinum)
- LAN 10ギガビット (x1) + ギガビット (x1)
- サイズ D500×W175×H435mm
- 有線キーボード・マウス:付属
- 3年間センドバック方式ハードウェア仕様
(グラフィックボードは1年間)



**NVIDIA RTX PRO 6000
Blackwell 96GB 搭載**

NVIDIA Blackwellアーキテクチャと96GB GDDR7メモリを搭載! 比類なき速度、精度、効率を提供するハイエンドグラフィックボード



オープン価格

お見積もりいたします。お問い合わせください。

上記仕様からカスタマイズも承ります。メモリ・ストレージの増設やグラフィックボード・OSの変更、また冷却性や耐久性が高い部品へのアップグレードも可能です。

高性能HPC専用筐体 タワー型&ラック型対応
日本国内専売モデル採用

8TB高耐久HDD 2基
RAID1 仕様

生物・医用・材料研究のための次世代高度3D画像処理ソフトウェア



AIによる先進的セグメンテーション機能搭載
SEM/TEM, CT, MRI, 光学顕微鏡の3D解析に最適